



三星電子推出 PM1733 SSD 和高密度 DIMM 支援 AMD EPYC™ 7002 系列處理器

三星電子宣布推出 Samsung PM1733 PCIe 第四代固態硬碟(SSD)，以及高密度 RDIMM^(註一)和 LRDIMM^(註二)動態隨機存取記憶體(DRAM)，支援最新發佈的 AMD EPYC™ 7002 系列處理器，進一步鞏固其在記憶體市場的龍頭地位。AMD 於舊金山推出第二代 AMD EPYC™ 處理器。

三星電子記憶體產品規劃資深副總裁 Jinman Han 談到：「在開發第二代 AMD EPYC 處理器的過程中，我們聆聽客戶的需求並與三星電子密切合作，以整合我們最先進的記憶儲存產品。透過全新的數據中心處理器，AMD 為現代數據中心的客戶，帶來樹立全新標竿的處理器。」

AMD 資料中心解決方案群企業副總裁暨總經理 Scott Aylor 表示：「三星電子大力支援第二代 AMD EPYC 處理器的推出，能擁有這樣的合作夥伴，我們感到既興奮又感激。透過兩倍核心、突破性的效能表現和嵌入式安全性能，並在領先架構的全面優化下，客戶可以隨著業務的成長速度，為數據中心的營運帶來轉型。」

AMD EPYC™ 7002 系列處理器每個插槽的性能預計將比前一代成長二倍^(註三)，峰值 FLOPS 將高出四倍^(註四)。新款處理器能為 8-64 核心「Zen 2」架構，帶來一致與全面性的 I/O、記憶體與安全性能。



相較於目前的第三代 SSD，三星電子新推出的 PCIe 第四代 PM1733 SSD 具有二倍的存取速度，在性能表現上領先現今市場上的任何固態硬碟。循序讀取速度達到每秒 8.0GB，隨機讀取速度則達到 1500K IOPS，提供 U.2(Gen 4 x4)和 HHHL(Gen 4 x8)兩種不同規格，最大硬碟容量分別為 30.72 TB 與 15.36 TB。該硬碟以第五代 512 Gb TLC V-NAND 技術生產。

三星電子將於本季向業界推出 PM1733 硬碟，包含 U.2 和 HHHL 兩種規格，並將向下相容於 PCIe 第三代架構，為現有和未來的伺服器應用帶來卓越的靈活性。該硬碟也具備支援儲存和伺服器應用的雙埠功能。

除了 PM1733 SSD 外，三星電子也針對 AMD EPYC 7002 系列處理器，推出全系列的 RDIMM 和 LRDIMM DRAM 產品。在 8Gb 和 16Gb DDR4 組件架構的應用下，三星電子能提供 8GB 到 256GB 的 DIMM 容量。借助三星電子的高密度 DIMM，用戶可建立每 CPU 高達 4TB 的大容量儲存環境。

註一：暫存器雙列直插式記憶體模組

註二：低負載雙列直插式記憶體模組

註三：截至 2019 年 7 月 3 日對 AMD EPYC 處理器提出的預估推測，採用內部電腦模擬的試產部件和 SPECrate®2017_int_base 測試結果，測試結果依量產之晶片組而異。截至 2019 年 6 月的 EPYC 7601 結果: <http://spec.org/cpu2017/results/res2019q2/cpu2017-20190411-11817.pdf>。SPEC®、SPECrate®和 SPEC CPU®是 Standard Performance Evaluation Corporation 的註冊商標。詳情請造訪該公司官網 www.spec.org。

註四：基於「Zen2」的處理器估計每插槽的浮點數(FLOPS)，相比「Zen1」的處理器高 4 倍。